

# IRDA-WELDER 用户使用手册

型号:T862++



## 目 录

---

1. 产品特点	.....	2
2. 主要参数	.....	2
3. 主要部件	.....	2
4. 主要部件功能说明	.....	3
(1) 主体	.....	3
(2) 前面板	.....	3
(3) 后面板	.....	4
(4) 调焦支架	.....	4
5. 装机步骤	.....	5
(1) 装入导柱	.....	5
(2) 装入定位环	.....	5
(3) 整体装配	.....	5
(4) 连接红外灯体连接线	.....	6
6. 使用说明	.....	6
(1) 开机	.....	6
(2) 拆焊	.....	7
(3) 回焊	.....	7
(4) 936 使用	.....	7
7. 注意事项!	.....	8

## 产品特点

- 采用自主研发的红外线拆焊技术。
- 专用红外线加热，穿透力强，器件受热均匀，突破传统热风拆焊机罩住元件加热，热冲击较大缺点。
- 操作容易，经过一天训练即可完全操作本机。
- 无需拆焊治具，本机可拆焊 15-35mm 所有元件。
- 本机配备 600W 预热溶胶系统，预热范围 120x120mm。
- 红外线加热无热风流动，不会影响周边微小元件，可适用所有的元件，尤其是 BGA、SMD 元件。

## 主要参数

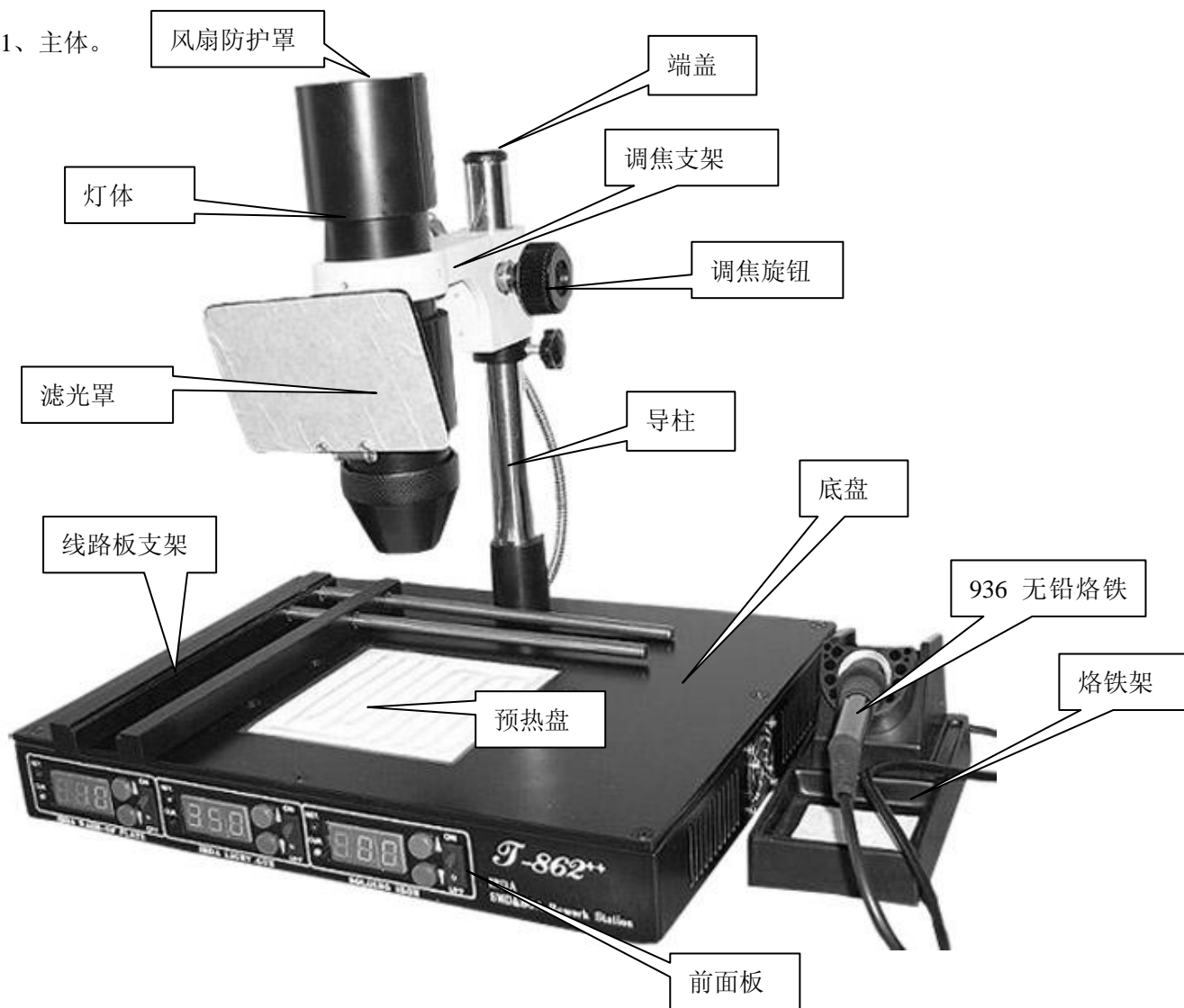
电源电压	AC220v 50Hz
功率	800W
红外灯体温度范围	100℃-350℃
底盘预热温度范围	60℃-200℃

## 主要部件

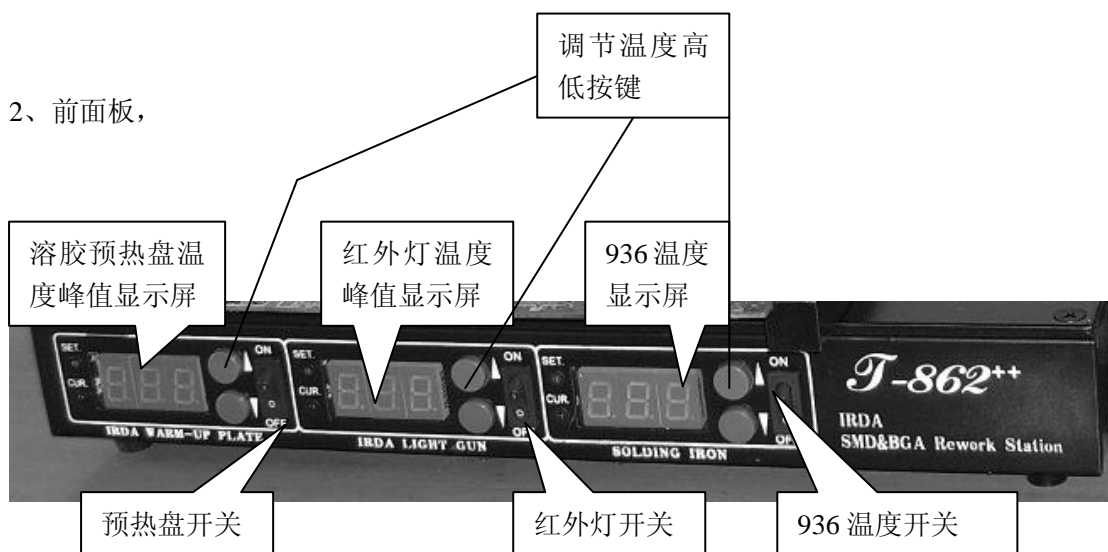
底盘	1
导柱	1
灯体	1
定位环	1
线路板支架	1
936 烙铁头	1
烙铁架	1
电源线	1
用户使用手册	1

## 主要部件功能说明

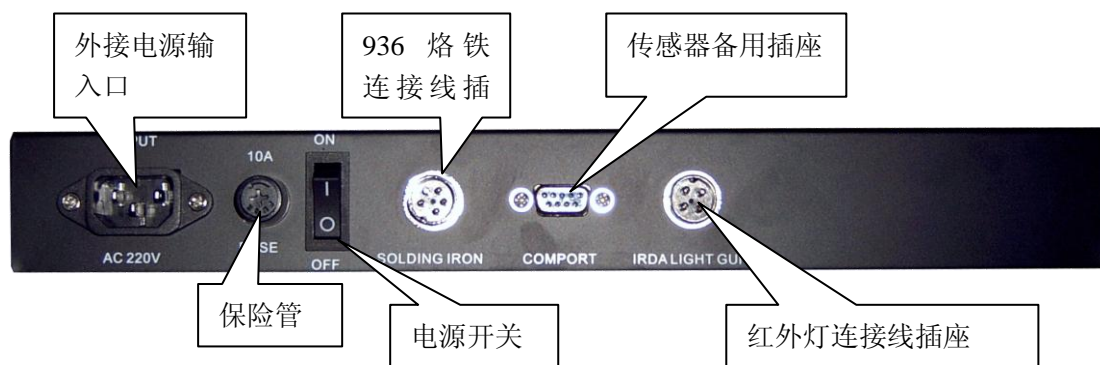
### 1、主体。



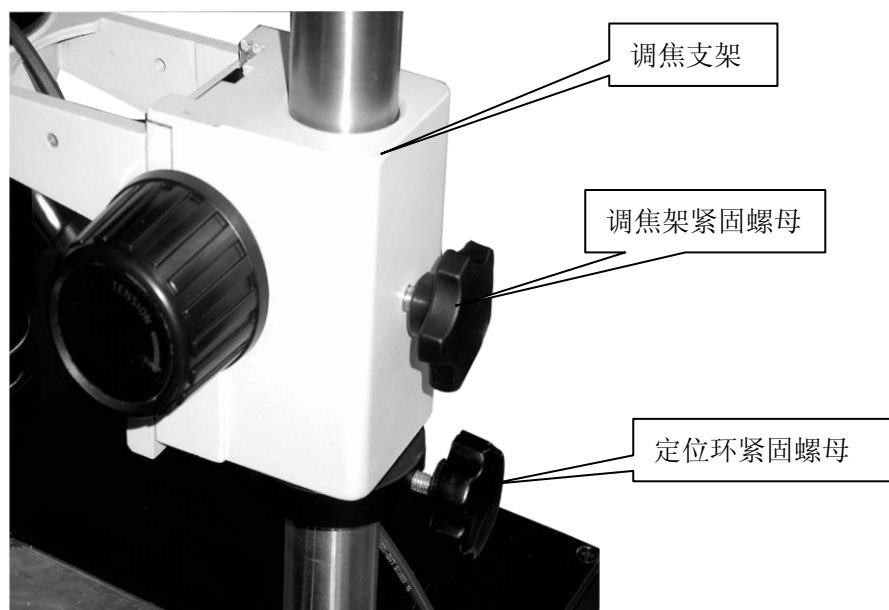
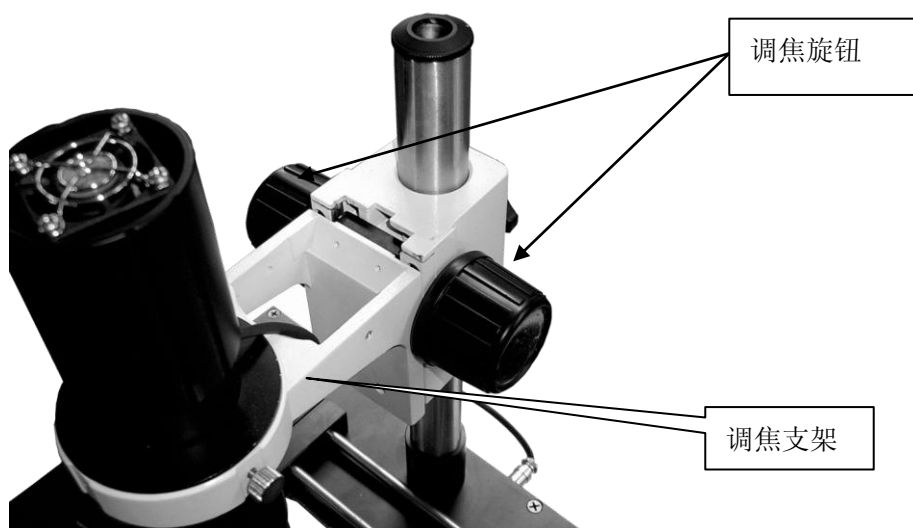
### 2、前面板，



### 3、后面板



### 4、调焦支架。

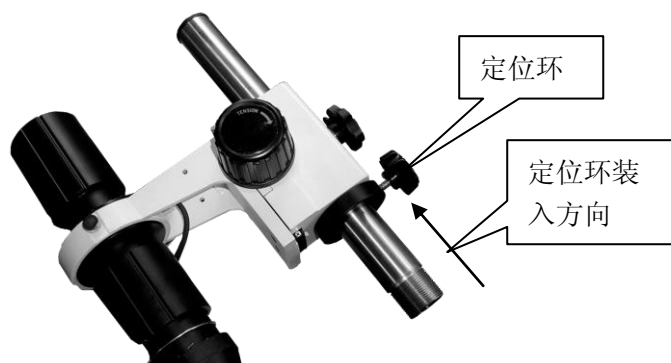


## 装机步骤

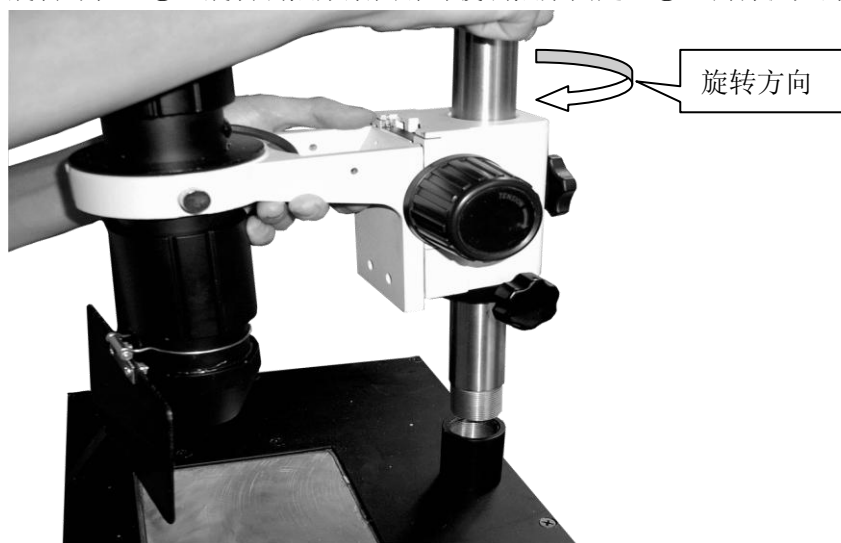
1、装入导柱。首先放松调焦架紧固螺母，再按箭头指示方向插入导柱。



2、装定位环。放松定位环紧固螺母，再按箭头指示方向装入定位环，装入后旋转定位环紧固螺母使其固定在相应高度。

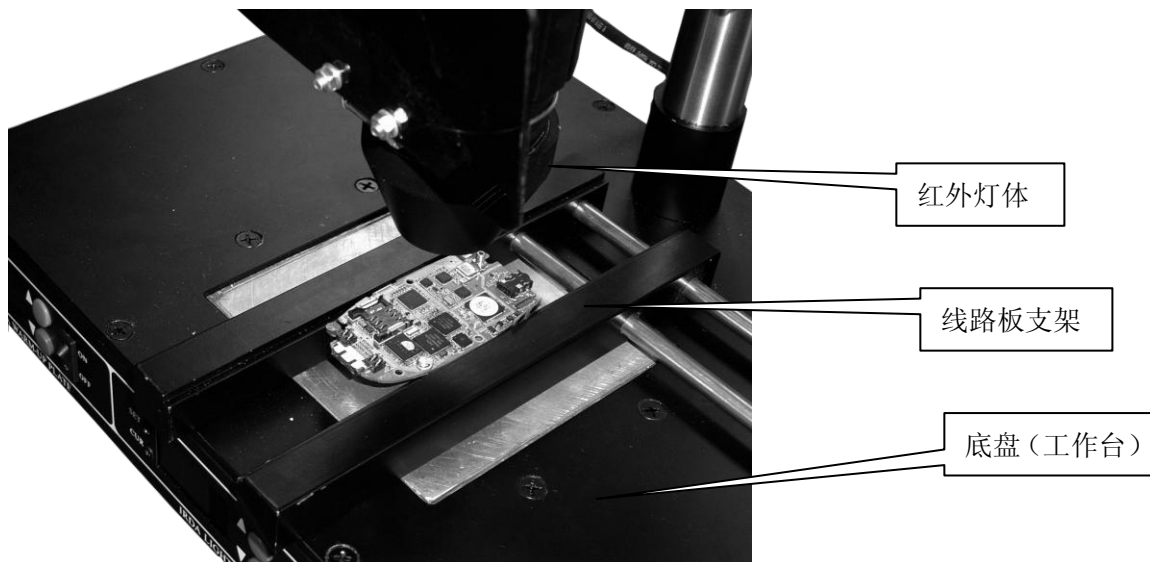


3、整体装配。①、放松调焦架紧固螺母。②、拿起调焦支架，使导柱对准底盘相应螺母，旋转导柱。③、旋转调焦架紧固螺母使调焦架固定。④、揭掉滤光片的防护纸塑膜。



4、连接红外灯体连接线和 936 无铅电烙铁。①将连接线插头对准插入相应连接线插座。②向右旋转固定螺丝。

## 使用方法



### 1、开机：

- ①、检查灯体及电源线是否连接好。
- ②、打开电源开关。等自检通过后再使用（面板显示屏上显示为上次使用时设定值）。
- ③、前面板三个开关，分别控制预热熔胶盘、灯体和无铅 936 电烙铁工作。
- ④、按动温度调节按钮，可以调节各窗口的设定值，∧升高，∨减小设定值，按后自动存储到机器里。下次开机显示当前值。

### 2、拆焊：

#### ①、线路板的放置和灯体高度的调节：

将线路板固定在线路板支架上，调节定位环及调焦架旋钮，使芯片垂直对准灯体的焦斑；调整灯体高度，保持灯头与拆焊物件高度为 20-30mm 为宜。

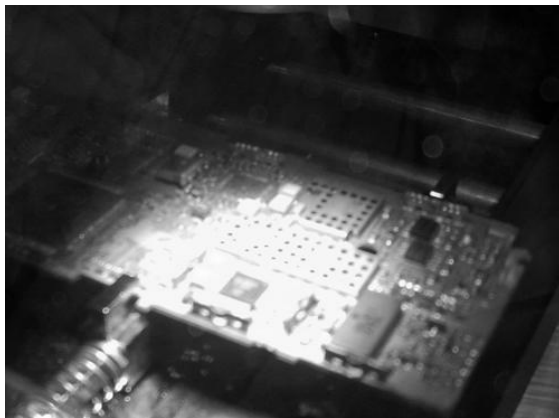
#### ②、预热盘的温度设置：

一般的拆焊无铅焊接的芯片、大于 30x30mm 和涂有防水固封胶的芯片，一定要先给线路板进行预热熔胶。一般预热温度设定：有铅焊接的板子，设定预热温度 120-140 度；无铅的线路板设定预热温度 160-200 度，（这是预热盘的温度）。

开启预热底盘，使显示温度稳定在设定值左右 3-5 分钟，再开启红外灯加热芯片，才能保证除胶和预热的要求，拆焊才会成功。

#### ③、调节灯体温度峰值：

根据拆焊芯片大小，适当调节灯体输出温度峰值，温度峰值由 100-350℃ 可调；拆小于 15x15mm 芯片时，可调节到 160-240℃ 左右，拆 15x15mm-30x30mm 时，可调节温度峰值到 240-320℃，拆大于 30x30mm 芯片时调到 350℃，此时灯体保持直射，此时红外线光最强（请注意自我控制时间，防止芯片过热烧坏）。注意：温度峰值低于 248℃ 以下时，灯光会间断闪耀，断续加热。



④、不同灯头的选取。灯体最小光斑直径为 15mm，最大可调焦斑直径 50mm，视不同芯片而定。使用时，根据芯片大小，选取不同的灯头。备有直径 $\Phi 28$ 、 $\Phi 38$ 、 $\Phi 48$  的三个灯头，分别满足小于 15x15mm、15x15-30x30mm 和大于 30x30mm 的芯片拆焊需求。更换灯头后，可根据芯片大小，调节调焦旋钮。使光斑全罩住芯片为宜。

⑤、拆焊芯片前，先在芯片底部或侧面注入少量助焊剂，可以得到完好的锡珠，同时可以保护好焊盘，使拆焊过程更流畅。

⑥、过适宜时间后，锡点熔化，取出芯片。一般拆小于 15x15mm 以下的，20-40s 左右；拆 15x15mm-30x30mm，30-60s 左右；大于 30x30mm 芯片，60-90s 左右；



### 3、回焊：

①、清洁焊盘：用机器自带的 936 快速烙铁配合**吸锡线**、**助焊剂**，清理好焊盘。涂一点液体助焊剂备用。



②、先将植好锡球或刮好锡浆的 BGA 芯片，按对位要求轻轻放在已清理好的焊盘上。再将线路板固定在线路板支架上，调节支架，使芯片垂直对准灯体的焦斑；然后调整灯体高度，保持灯头与拆焊物件高度为 20-30mm 为宜。

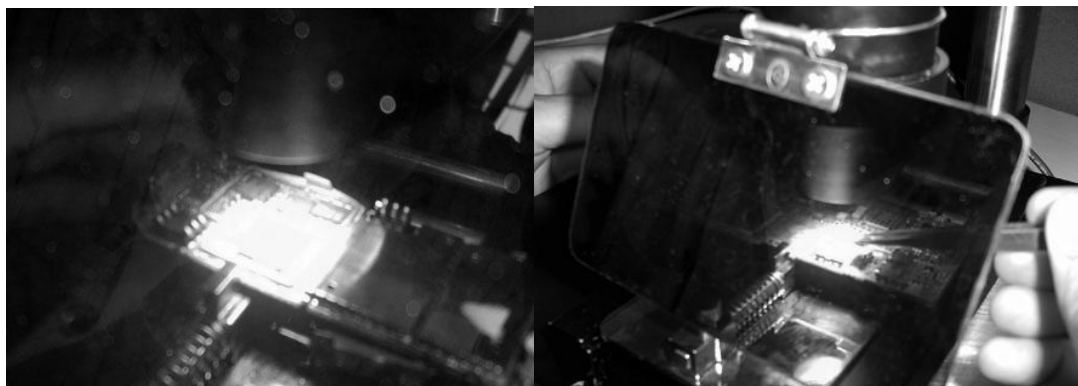
③、开启预热盘开关，预热，等达到预热温度后（此时助焊剂已经开始浸润焊盘还原焊盘氧化物），快速开启顶部加热灯，等助焊剂挥发后，芯片塌落 10 秒内关掉顶部和预热盘，



等板子冷却到 100 度以下后，将板子取走，放一旁冷却。

④、将焊好已冷却的板子，用洗板液清洗并干燥后，可以通电测试。如果测试通不过，先查找原因，明确原因后再搞，防止多次焊接损毁板子。

⑤、936 快速无铅烙铁使用：打开电源开关，设定所需要温度，开启控制开关即可。



\*\*\*、一般通电测试不过的原因，有以下几点，仅供参考：

- 1、焊盘清理不好，虚焊；
- 2、锡浆回流温度不到，虚焊；
- 3、加热太快焊剂挥发太快，产生气爆，造成芯片移位、锡珠连接短路或锡珠缺位虚焊。
- 4、焊接完的板子一定要先等冷却后再清洗，不清洗或清洗后不干燥，通电会烧坏板子的。

## 注意事项

- 1、工作完毕后，不要立即关电源，使风扇冷却灯体。
- 2、保持通风口通风畅通，灯体洁净。
- 3、导柱、调焦支架适时用油脂擦拭。
- 4、长久不使用，应拔去电源插头。
- 5、小心，高温操作，注意安全。

**声明：** 用户使用说明书与实际产品之间不同的地方，以实际产品为准！